

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 4 区分

【発行日】平成20年11月20日(2008.11.20)

【公開番号】特開2007-182623(P2007-182623A)

【公開日】平成19年7月19日(2007.7.19)

【年通号数】公開・登録公報2007-027

【出願番号】特願2006-276055(P2006-276055)

【国際特許分類】

C 2 5 D 7/00 (2006.01)

C 2 5 D 1/04 (2006.01)

C 2 5 D 3/38 (2006.01)

【F I】

C 2 5 D 7/00 J

C 2 5 D 1/04

C 2 5 D 3/38 1 0 1

【手続補正書】

【提出日】平成20年10月6日(2008.10.6)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 3 4

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 3 4】

本実施形態で得られる銅薄膜（製品）は、上記のような特徴を有し、特に（1 1 1）面の配向性を高めることができるため、例えば銅薄膜（製品）表面を平滑とし、且つピンホールの発生を抑制することができ、さらには加工性を高めることができる。

よって、本発明によって得られる銅薄膜（銅薄体）は、各種用途に用いる金属膜、金属箔、金属テープ、金属シート、金属板などとして利用することができ、特に電子材料、例えば IC 等の実装基板やフィルムコンデンサ等の電極材料、TAB テープ、COF テープなどに利用することができる。